

证券代码：688279

证券简称：峰昭科技

峰昭科技（深圳）股份有限公司
投资者关系活动记录表

2023年11月9日-11月10日

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 网络会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	泰信基金 申万菱信基金 易方达基金 博时基金 宝盈基金 农银汇理基金 景顺长城基金 民生证券 建信基金 汇添富基金 国投瑞银基金 海通证券
时间	2023年11月9日、10日
地点	公司会议室
上市公司接待 人员姓名	董事长、总经理：B I L E I 财务总监：林晶晶 董事会秘书：黄丹红
投资者关系活动 主要内容	<p>公司2023年第三季度报告已于2023年10月25日依法披露，季报披露后公司通过多种方式与投资者进行了互动交流。相关交流内容汇总如下：</p> <p>1、经营业绩情况</p> <p>2023年第三季度，公司实现营业收入10,263.78万元，较上年同期增长56.37%，归属于上市公司股东的净利润为4,081.55万元，较上年同期增长26.51%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,991.19万元，较上年同期增长56.46%。公司通过加强研发投入，大力推进技术创新，不断增强产品竞争优势，持续进行战略布局、市场拓展等举措，实现公司业绩增长。</p> <p>2、研发投入情况</p> <p>公司的核心技术涵盖高性能电机驱动控制芯片设计技术、电机驱动架构算</p>

法技术及电机技术三个技术领域，公司持续在上述技术领域进行研发和攻关，巩固和提升技术竞争优势。公司在新兴应用领域持续进行研发前沿布局，在车规级芯片研发、工业控制等领域持续投入。2023 年前三季度，公司研发投入总计 5,200.70 万元，同比增长 40.40%，研发投入占营业收入比例为 18.47%，同比提高 2.62 个百分点。

3、研发团队情况

公司高度重视人才梯队建设，未来公司将继续吸引高端技术人员加入，通过社会招聘、校园招聘持续为研发团队注入新鲜血液，形成自主开放、晋升通畅的人才培养体系，建立以核心技术人员为核心，包括研发技术骨干、中层力量、后备力量在内的多层级研发人才梯队。

4、公司产品新兴应用领域拓展情况

公司持续深耕电机驱动控制专用芯片领域，专注于 BLDC 电机应用，产品广泛应用于智能小家电、白色家电、散热风扇、电动工具、运动出行、工业与汽车等领域。公司始终坚持在巩固既有应用领域的同时不断深耕新兴应用市场，着力培育发展新引擎，并在拓展应用领域的同时，不断优化芯片产品以及架构算法，提升芯片产品的可靠性、稳定性、运算能力等，以满足终端更高的性能要求。

面对汽车电子领域的高可靠性要求、高门槛，公司从体系建设、研发攻关、系统级服务等方面着手，全面深耕汽车电子市场。2023 年公司通过 ISO 26262 功能安全管理体系认证，成为公司车规级芯片发展的重要里程碑。在市场拓展上，汽车电子领域的验证周期长，公司以系统级技术支持积极推动芯片产品在汽车电子领域从小批量试产逐步进入量产。未来公司将持续深耕新兴领域，以优异的芯片产品和驱动控制技术助力下游新兴领域的成长和发展。

5、公司产品的技术壁垒

公司从底层架构上将芯片设计、电机驱动架构、电机技术三者有效融合，用算法硬件化的技术路径在芯片架构层面实现复杂的电机驱动控制算法，形成自主知识产权的电机驱动控制处理器内核，不受 ARM 授权体系的制约，并在芯片电路设计层面在单芯片上全集成或部分集成 LDO、运放、预驱、MOS 等器件，最终设计出的电机驱动控制专用芯片产品具备高集成度、能实现高效率、

低噪音控制且能完成复杂控制任务，持续满足下游领域不断变化的应用需求。

芯片技术、电机驱动架构技术、电机技术三个领域的丰厚技术积累，使公司可以为下游客户有针对性地提供包括驱动控制专用芯片、应用控制方案设计、电机系统优化在内的系统级服务，并有能力引导、协助下游客户进行系统级产品升级换代。